

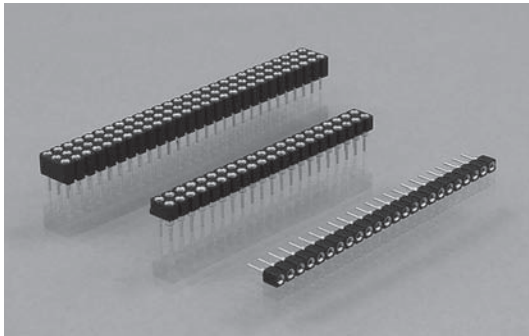


R801 R803
R805

PCBレセプタクル2.54mm

PRECI-DIP

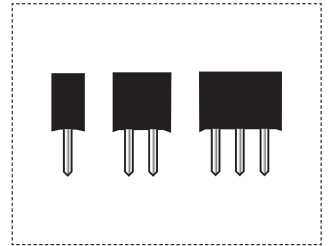
(寸法単位:mm)



PCBレセプタクル
ハンダ付タイプ

仕様

適合ピン径: $\varnothing 0.70 \sim 0.90\text{mm}$, $\square 0.635\text{mm}$
挿抜力: 挿入力 1.2N typ./引抜き力 0.6N typ.
(研磨したスチールゲージを使用 $\varnothing 0.76\text{mm}$)
機械的寿命: 500回(最低)
定格電流: 3A
接触抵抗: 10m Ω (最大)
耐電圧: 1,000Vrms(最低)



適合ピンシリーズ
R350/R450/R800/R802/
R804/R890/R892/R894

PCBコネクタ2.54mm



任意のピン数にカットして販売。

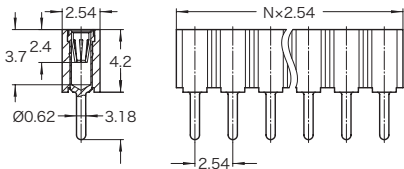
下記の標準ピン数以外をご希望される場合の型番は、ピン数を変更するだけです。

型番構成例

シリーズ メッキ ピン数 形状番号
R801 - **83** - **016** - **10-012** (この型番の総ピン数は16ピンです)
↑
任意のピン数を入れる。標準のピン数は下記参照。

R801...10-012シリーズ

スタンドオフタイプ低背型 1列 ピン数 2~32



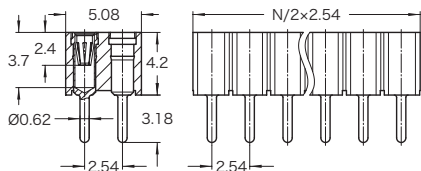
メッキ仕上げ	ピン数		
スリーブ 0.1mm	20ピン	32ピン	任意のピン数*
純錫	0.75 μm 金	R801-83-020-10-012	R801-83-032-10-012
			R801-83-xxx-10-012

■スタンドオフタイプの低背型シングルインライン・レセプタクル
■高さ4.2mm。最大32ピン

xxxにピン数を入れて下さい。2~32ピン

R803...10-012シリーズ

スタンドオフタイプ低背型 2列 ピン数 4~64



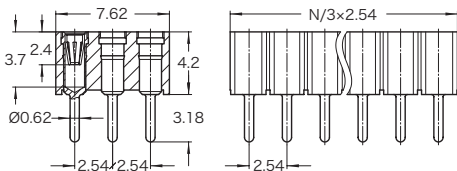
メッキ仕上げ	ピン数		
スリーブ 0.1mm	64ピン	—	任意のピン数*
純錫	0.75 μm 金	R803-83-064-10-012	—
			R803-83-xxx-10-012

■スタンドオフタイプの低背型ダブルインライン・レセプタクル
■高さ4.2mm。最大64ピン

xxxにピン数を入れて下さい。4~64ピン

R805...10-012シリーズ

スタンドオフタイプ低背型 3列 ピン数 9~96



メッキ仕上げ	ピン数		
スリーブ 0.1mm	—	96ピン	任意のピン数*
純錫	0.75 μm 金	—	R805-83-096-10-012
			R805-83-xxx-10-012

■スタンドオフタイプの低背型トリプルインライン・レセプタクル
■高さ4.2mm。最大96ピン

xxxにピン数を入れて下さい。9~96ピン



PCBコネクタ/レセプタクル一般仕様

以下の仕様は、PCBレセプタクル及びコネクタに適用の一般仕様です。追加および製品仕様のテクニカルデータについては個々のカタログページをご覧ください。

一般仕様

動作温度範囲	-55~+125°C
耐候性分類(IEC)	55/125/21
動作湿度範囲(域)	年平均75%
最大定格電圧	AC100Vrms/DC150V(2.54mmピッチ)

UL PRECI-DIP製品はUL(Underwriters Laboratories Inc.)認定品です。
UL規格「データ、信号、制御及び電力用途使用のコネクタ」にリストされています。File Nr. E174442

機械的特性

クリップ維持力	40N(最小、軸方向力適用では無変位)
コンタクト(スリーブ/クリップ)維持力	3.3N(最小) MIL-DTL-83734,pt4.6.4.2

電機的特性

隣接コンタクト間での絶縁抵抗値	10,000MΩ(最小、500Vacにて)				
隣接コンタクト間の静電容量	1pF(最大)				
隣接コンタクト間の沿面距離	3xx/4xx/7xxシリーズ 0.7mm	80xシリーズ 0.85/0.7mm	83xシリーズ 0.5mm	85xシリーズ 0.4/0.5mm	86xシリーズ 0.5mm

環境特性

ソケットは以下の環境試験において機械的/電気的に支障無く耐えることが出来ます。

乾熱試験	IEC 60512-11-9.11i/60068-2-2.Bb	温度125°C, 16時間
湿熱試験	IEC 60512-11-12.11m/60068-2-30.Db	温度25/55°C, 湿度90-100%RH, 1サイクル24時間
低温試験	IEC 60512-11-10.11j/60068-2-1.A	温度-55°C, 2時間
熱ショック試験	IEC 60512-11-4.11d/60068-2-14.Na	温度-55/125°C, 5サイクル30分
振動(正弦)試験*	IEC 60512-6-4.6d/60068-2-6.Fc	10~500Hz, 10g, 1オクターブ/分, 各軸方向10サイクル
衝撃試験*	IEC 60512-6-3.6c/60068-2-27.Ea	50g, 11ms, 3軸方向3衝撃
※上記二つの試験中に50ns以上のコンタクトの瞬断が無い事。		
ハンダ付性	J-STD-002A	Test A, 245°C, 5秒間, ハンダ SnAg3.8Cu0.7
ハンダ付耐熱性	J-STD-020C	260°C, 20秒
耐湿性	J-STD-020C	level 1
耐腐食性	1) 塩水噴霧試験	IEC 60068-2-11.Ka 48時間
	2) 二酸化硫黄ガス(SO2)試験	IEC 60068-2-42 Kc 25ppm SO ₂ , 25°C, 75%RHで96時間
	3) 硫化ガス(H2S)試験	IEC 60068-2-43 Kd 12ppm H ₂ S, 25°C, 75%RHで96時間

無ハンダ対応プレスフィット特性

プレスフィット特性はIEC60325 -5に対応して測定されています。

挿入力	90N(最大)@最小穴直径/65N typ.	
引抜力	30N(最小)@最大穴直径/50N typ.	
引抜力 3サイクル時	20N(最小)@最大ホール直径	
PCBホール寸法	2mmピッチ	仕上げ穴: Ø0.7+0.09/-0.06mm, ドリル穴: Ø0.8±0.2mm
	2.54mmピッチ	仕上げ穴: Ø2+0.09/-0.06mm, ドリル穴: Ø1.15±0.02mm
PCBホールメッキ	PCB表面処理	ホールメッキ
	錫	5-15µm錫(最小、25µm銅の上)
	銅	25µm(最小)
	金(ニッケル上)	0.05-0.2µm金(最小、25µm銅の上に2.5-5µmニッケル)

材質

シリーズ	右記以外	R830/R831/R832/R833	R831...64-001/R833...64-001/ R831...64-242/R833...64-245
インシュレーター	ガラス封入熱可塑性樹脂ポリエステル、UL94 V-0、黒色、PCT-GF30FR	ガラス封入熱可塑性樹脂ポリエステル、UL94 V-0、黒色、LCP-GF30-FR	ガラス封入熱可塑性樹脂ポリエステル、UL94 V-0、黒色、LCP-GF30-FR
スリーブ	CuZn36Pb3(C36000)	CuZn36Pb3(C36000)	CuDn4Pb4Zn4(C54400)
コンタクト		ベリリウム銅(C17200)	

